

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-003

# 天水华天科技股份有限公司

## 关于公司本次发行摊薄即期回报 采取填补措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规和规范性文件的规定，为维护天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，公司就本次非公开发行A股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

### 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

#### （一）主要假设及测算说明

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。具体假设如下：

1、假设以公司截至2020年9月30日的总股本2,740,003,774股为基数测算，本次发行股数不超过680,000,000股，本次发行完成后公司总股本为3,420,003,774股；

2、假设本次发行于2021年9月30日完成（上述完成时间仅用于计算本次

发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准)；

3、假设本次发行最终募集资金总额为 510,000 万元，不考虑发行费用影响；

4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场没有发生重大不利变化；

5、根据公司 2020 年第三季度报告，2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 44,736.93 万元，同比上升 166.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 37,478.02 万元，同比上升 350.90%；按照该等数据的 4/3 预测公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 59,649.24 万元和 49,970.69 万元；假设公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较 2020 年度增长 10%；

6、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

7、假设在测算 2020 年和 2021 年相关财务指标影响时，不考虑 2020 年度和 2021 年度利润分配的影响；

8、假设 2020 年度及 2021 年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他可能产生的股权变动事宜；

9、假设在测算公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述主要假设及测算说明，本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下：

项目	2020 年度/	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	
	2020 年 12 月 31 日	本次发行前	本次发行后
期末总股数（股）	2,740,003,774	2,740,003,774	3,420,003,774
本次募集资金总额（元）		5,100,000,000.00	
本次发行股份数量（股）		680,000,000	
预计发行完成时间		2021 年 9 月	
归属于上市公司股东的净利润（万元）	59,649.24	65,614.16	65,614.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	49,970.69	54,967.76	54,967.76
期初归属于母公司所有者权益（万元）	776,810.76	836,460.00	836,460.00
期末归属于母公司所有者权益（万元）	836,460.00	902,074.17	1,412,074.17
基本每股收益（元/股）	0.2176	0.2395	0.2255
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1824	0.2006	0.1889
加权平均净资产收益率（%）	7.39	7.55	6.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.19	6.32	5.51

注 1：本次发行后期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+归属于母公司所有者的净利润+本次发行融资额；

注 2：本次发行前基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者净利润（扣非前后）/发行前总股本；本次发行后基本每股收益（扣非前后）=当期归属于母公司所有者净利润（扣非前后）/（发行前总股本+发行月份次月起至年末的累计月数/12\*本次新增发行股份数）；

注 3：本次发行前加权平均净资产收益率（扣非前后）=当期归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）/（期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者净利润/2）；本次发行后加权平均净资产收益率（扣非前后）=当期归属于母公司所有者的净利润（扣非前后）/（期初归属于母公司所有者的净资产+本次发行次月至年末的累计月数/12\*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2）。

## 二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金产生效益需要一定的时间，对公司的业绩提升需要一定时间才能全部释放。因此，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在短期内出现一定幅度下降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。此外，受外部因素的影响，公司经营过程中面临经营和市场等方面风险，对公司生产经营可能产生影响，不排除公司 2020 年度和 2021 年度实际取得的经营成果低于财务预算目标的可能性，并导致本次发行对即期回报摊薄的情形。

公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

### 三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次发行有利于改善公司财务状况、提升公司综合竞争力。本次募集资金投资项目符合公司整体战略规划,为进一步提升公司先进集成电路封测技术生产能力打下重要基础,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于增强公司的盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次募投项目的必要性和合理性分析,请参见《天水华天科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”。

### 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

#### (一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司作为国内领先的集成电路封装测试企业,在中国天水、宝鸡、西安、上海、昆山、南京、成都、深圳及美国凤凰城、马来西亚怡保设立了产业基地,产业规模位列全球集成电路封测行业前十。目前,公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-out 等多个系列。公司产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。2019 年,公司实现营业收入 81.03 亿元,完成集成电路封装量 331.88 亿只,同比上升 24.19%,晶圆级集成电路封装量 85.15 万片,同比增长 50.98%。

本次募投项目的实施将进一步提升公司在集成电路先进封装测试领域的工艺和技术水平,扩大先进封装测试产能,有助于巩固、提升公司在行业中的地位,促进公司的持续快速发展。

#### (二) 本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

##### 1、人员

公司始终将引进、留住、培养和重用适应公司未来发展的高端人才作为人力资源工作的重点。公司根据各部门的业务发展特点及人才需求,制定了人才引进的计划以及吸引人才的优惠政策。在引进人才的同时,公司每年按照员工岗位和层级制定培训计划,有针对性的满足各类员工的培训需求,并通过完善员工晋升

通道，构建了有行业竞争力的薪酬与绩效考核体系，让广大员工分享企业发展的成果，激发其更大的工作热情。

## 2、技术

公司根据市场和客户需求以及集成电路封装技术发展趋势，持续开展集成电路先进封装技术和产品的研发，并通过国家科技重大专项的实施，不断加大科技创新与技术研发投入力度，加快集成电路先进封装技术和产品研发及产业化步伐，努力提高公司技术水平和核心竞争力。在制度创新方面，公司不断完善整体科技创新管理体系，加强与国内外各大大专院校及科研院所的技术合作与交流，建立以公司为主体，产、学、研、用有机结合的技术创新体系，全面提升公司新产品、新工艺、新技术的研发能力，以适应行业的技术进步及客户对产品和服务的更高要求，进一步提升在行业内的领先优势。

## 3、市场

公司拥有稳定的客户群体和强大的销售网络，得到了客户的广泛信赖，建立了长期良好的合作关系。近年来，公司在稳步扩展国内市场的同时，不断加大国际市场的开发力度，有效的拓展了国际市场，现已形成布局全球的销售格局，为公司的发展提供了有力的市场保证，降低了市场风险。

因此，公司本次募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础，随着业务规模的逐渐扩大，公司将不断加强人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和升级的需求。

## 五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

### （一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

#### 1、公司现有业务的运营状况及发展态势

公司主营业务为根据客户要求，提供集成电路封装与测试服务。2014年-2019年，公司经营规模持续扩大，资产总额从 41.58 亿元增加到 160.45 亿元，年复合增长率为 31.01%，营业收入从 33.05 亿元上升到 81.03 亿元，年复合增长率为 19.65%。目前公司集成电路封装产品已有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、

TSV、Bumping、MEMS、Fan-out 等多个系列，产品主要用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子等领域。

## 2、公司现有业务板块面临的主要风险

### (1) 受半导体行业景气状况影响的风险

公司经营业绩与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动使公司面临一定的行业经营风险，从而影响公司的经营业绩。另外，公司境外收入及采购额占比较高，若未来国际形势、宏观经济、产品价格、客户及供应商所在地的进出口政策、行业竞争、技术迭代等方面出现不利变化或发生不可预见事项，也可能对公司经营业绩产生不利影响。

### (2) 产品生产成本上升的风险

公司主要原材料的价格变化及人力成本的上升，会导致公司经营业绩出现波动。

### (3) 技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发与新产品开发失败的风险。

### (4) 负债规模增加的风险

公司所处的集成电路封装测试行业属于资本密集型行业。随着公司经营规模的扩张，公司生产经营所需的原材料采购成本、人力资源成本、动力运行成本等支出也相应增长，资金需求量较大。为了满足日常生产经营需要，除自身积累外，公司主要通过银行贷款、股权融资等方式筹集资金。经营规模的不断扩大导致公司负债规模增加，提高了公司的财务风险。

## 3、为应对上述风险，公司拟采取的应对及改进措施

(1) 公司将进一步加强宏观经济研判，密切关注经济形势变化、政策走向，提高政策和市场的敏感性，增强政策与市场风险意识，以抵御复杂的外部环境带来的挑战。

(2) 密切关注相关市场需求变化，把握行业技术前沿的信息和动态，坚持技术创新，完善研发流程，加大研发投入和技术改造，同时提升产品质量，加强品牌营销和市场开拓力度，发掘新的目标市场，提高公司的综合竞争实力。

(3) 未来公司将继续完善营销网络建设，并根据国外销售情况，不断完善海外营销网络，扩大产品出口，提高企业的国际知名度，巩固并扩大与国际知名集成电路厂商的长期合作关系。在开拓海外市场的同时，公司也将在设备采购、业务交流、技术开发方面加强与国际大型集成电路企业的合作，引进和吸收先进的管理方法，把握前沿的技术发展趋势，从而提升公司参与国际竞争的實力。

(4) 未来，公司将根据各部门的业务发展特点及人才需求，制定人才引进的计划以及吸引人才的优惠政策，不断引进包括研发、运营、管理等各方面的专业人才。同时，针对市场趋势和员工需求为员工提供高质量的培训机会，培养后备人员，为公司未来的快速发展提供强有力的人力资源保障，满足公司业务持续快速发展的需要。

(5) 公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，形成科学高效的决策机制，为公司业务发展提供制度保障，实现公司和股东利益的最大化。

## **(二) 提高未来回报能力采取的主要措施**

为保证募集资金有效使用、防范本次非公开发行摊薄即期回报所造成的风险，公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩，为股东持续创造回报，具体如下：

### **1、严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照相关法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。

根据《募集资金使用管理办法》，本次非公开发行股票募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途；通过子公司或者公司控制的其他企业实施项目的，应当由该子公司或者公司控制的其他企业开设募集资金专户并存放及管理募集资金。公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业銀行签订三方监管协议。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。公司当年存在募集资

金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告；保荐机构或者独立财务顾问应当至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

### 2、提高公司运营资金使用效率，提升公司主营业务经营业绩

公司将进一步提高资金运营效率，在稳步扩展国内市场的同时，通过进一步加大对国际市场的开发等措施，提升公司主营业务的经营业绩，应对行业波动给公司经营带来的风险。同时公司将根据市场和客户需求以及集成电路封装技术发展趋势，持续积极开展集成电路先进封装技术和产品的研发，保证公司竞争优势和持续盈利能力。

### 3、严格执行利润分配政策，保障投资者回报机制的落实

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件精神 and 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《2020年度-2022年度股东回报规划》。该规划明确了未来三年股东的具体回报计划，建立了股东回报规划的决策、调整和信息披露机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

## 六、相关主体做出的承诺

### （一）公司董事、高级管理人员承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，全体董事、高级管理人员已作出承诺如下：

- “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

- 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、若公司未来拟公告或实施股权激励政策，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公告或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7、自承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 8、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺函，如果违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

## **(二) 公司控股股东、实际控制人承诺**

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东和实际控制人已作出承诺如下：

- “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺函，若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺将依法承担相应的法律责任；
- 3、自承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

## **七、关于本次发行摊薄即期回报及填补措施的审议程序**

董事会对公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施等事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日